

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2026-0261

北京万通新发展集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度股东大会,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:本次计提长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、存货跌价准备及应收款项信用减值准备金额合计为36.281万元,将减少公司2025年度合并报表利润总额36.281万元。

一、计提资产减值准备具体情况
(一)长期股权投资减值准备
根据《企业会计准则》及其应用指南,为了更加真实、准确地反映公司在2025年12月31日的资产状况和财务状况,公司(含子公司、下同)对截至2025年12月31日的在减值准备的各类资产进行分类、评估并进行减值测试,经审计并按照账龄计提各类减值准备36.281万元。具体情况如下:

Table with 2 columns: Item (项目), 2025年度计提资产减值准备金额(万元) (2025年度计提资产减值准备金额(万元)). Rows include Long-term equity investment, Investment property, Inventory, and Receivables.

本次计提的减值(损失)准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、计提资产减值准备的相关说明
(一)长期股权投资减值准备
根据《企业会计准则》及《企业会计准则第8号——资产减值》及《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定,公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于可收回金额。出现类似情况时,公司应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可回收金额低于长期股权投资账面价值的,应当计提减值准备。

Table with 2 columns: Long-term equity investment (长期股权投资项目), 2025年度计提资产减值准备金额(万元) (2025年度计提资产减值准备金额(万元)). Rows list various subsidiaries like Beijing Taigong Technology Co., Ltd.

(1)北京太极通电子技术有限责任公司
北京太极通电子技术有限责任公司(以下简称“太极通”)主营业务为依托自有技术和资源,与行业合作伙伴共同开发并运营低空互联通信服务和低空智能网联网络等市场。

(2)湖北太极光电有限公司
湖北太极光电有限公司(以下简称“湖北太极”)主要从事第五代显示器件Mini& MicroLED的研发、生产和销售。

(3)北京大唐盛科技发展有限公司
北京大唐盛科技发展有限公司(以下简称“大唐盛”)主要从事卫星通信、低空空域管理软件开发等核心业务。

(4)投资性房地产减值准备
根据《企业会计准则》及《企业会计准则第8号——资产减值》及《企业会计准则第3号——投资性房地产》等相关规定,公司管理层应当关注投资性房地产账面价值是否大于可收回金额。

(5)存货跌价准备
根据《企业会计准则》及《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,公司在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,存货期末可变现净值低于账面成本的,计提存货跌价准备。

(6)应收款项减值准备
根据《企业会计准则》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司按照预期信用损失模型对应收款项进行了减值测试。

(7)计提其他应收款信用损失准备2,175万元
基于单项信用风险计提信用损失准备2,150万元,基于单项信用风险组合转回信用损失准备25万元。

(8)计提其他应收款信用损失准备21,578万元
基于单项信用风险计提信用损失准备21,578万元,基于单项信用风险组合转回信用损失准备0万元。

上述单项风险计提主要是公司对联营企业香河万通应收账款及其他应收款合计计提21,525万元损失准备。截至2025年12月31日,本公司对香河万通应收账款及其他应收款账面余额为62,395万元,累计计提损失准备金额为46,160万元(截至2024年12月31日,累计已计提坏账准备24,655万元)。

本期计提信用损失准备的主要原因是该公司2025年因被列为诉讼案件被执行人且涉及的金额较大,根据案情执行方案,香河万通需承担连带清偿责任。而香河万通项目一期整体规划仍在政府规划过程中,项目开发进展仍较滞后,且为响应政府要求,除承担连带清偿责任外,香河万通项目自有资金需优先满足安置房交付建设、农民工工资、安全施工保障等资金需求。

出于谨慎性原则,公司按照预期信用损失模型(ECL模型)对香河万通应收款项进行了减值测试,结合专业第三方评估公司出具的评估报告,对香河万通应收账款及其他应收款(含其他应收款)确认为2025年末减值准备金额为73,986元,并于2025年度计提信用损失准备21,525万元。

三、本次计提减值(损失)准备事项对公司财务状况的影响
本次计提减值(损失)准备金额合计为36.281万元,减少公司2025年度合并报表利润总额36.281万元,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司的资产价值和经营成果。

四、本次计提减值准备的审议程序
公司于2026年4月27日召开第九届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。审计与风险控制委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,且计提事项遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够公允反映公司财务状况及经营成果。审计与风险控制委员会全体成员无异议通过,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2026年4月28日,公司召开第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度股东大会,全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

北京万通新发展集团股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)重视对投资者的合理回报,严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,并结合《公司章程》的相关规定,执行利润分配政策。根据公司实际情况,2025年度利润分配预案如下:

一、利润分配预案的具体内容
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-65,481.55万元,母公司2025年度实现净利润-12,839.76万元,不提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币96,056.42万元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负的情况,综合考虑市场环境、行业现状和公司未来发展规划,为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施,稳步推进公司高质量发展,更好地保护全体股东的长远利益,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“指引”)及《公司章程》第11号——规范运作等法律、法规、规范性文件(以下简称“公司章程”)的规定,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、不提取其他应计提情形
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,因此不提取及《上海证券交易所上市公司监管指引第3号——规范运作》第8.1.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)重视对投资者的合理回报,严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,并结合《公司章程》的相关规定,执行利润分配政策。根据公司实际情况,2025年度利润分配预案如下:

一、利润分配预案的具体内容
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-65,481.55万元,母公司2025年度实现净利润-12,839.76万元,不提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币96,056.42万元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负的情况,综合考虑市场环境、行业现状和公司未来发展规划,为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施,稳步推进公司高质量发展,更好地保护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

截至报告期末,母公司在未弥补亏损的相关情况及对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第三部分基本情况

一、公司简介
1. 公司概况
2. 报告年度主要业务简介
3. 报告期内所处行业情况
4. 行业未来发展情况

2025年,全球及国内集成电路行业保持高速增长,在人工智能、算力基础设施、汽车智能化等下游需求驱动下,行业整体景气度持续提升。作为信息技术产业的核心,集成电路行业是支撑经济社会发展的基础性和先导性产业。2025年全球半导体市场规模持续扩大,逻辑芯片、存储芯片、交换芯片等细分领域增速显著高于行业平均水平。

2025年5月,国家工业和信息化部印发《算力基础设施行动计划(2025-2030年)》,重点任务是统筹算力资源、提升算力供给能力、优化算力应用生态、推动算力基础设施高质量发展。算力基础设施作为数字经济发展的核心引擎,在推动产业转型升级、提升国家竞争力方面发挥着关键作用。

报告期内,公司紧跟行业发展趋势,加大研发投入,持续推进技术创新,不断提升核心竞争力。在算力基础设施领域,公司凭借深厚的技术积累和丰富的行业经验,成功中标多个重大项目和标杆案例,业务规模持续扩大,市场地位稳步提升。

2025年,全球及国内集成电路行业保持高速增长,在人工智能、算力基础设施、汽车智能化等下游需求驱动下,行业整体景气度持续提升。作为信息技术产业的核心,集成电路行业是支撑经济社会发展的基础性和先导性产业。2025年全球半导体市场规模持续扩大,逻辑芯片、存储芯片、交换芯片等细分领域增速显著高于行业平均水平。

2025年5月,国家工业和信息化部印发《算力基础设施行动计划(2025-2030年)》,重点任务是统筹算力资源、提升算力供给能力、优化算力应用生态、推动算力基础设施高质量发展。算力基础设施作为数字经济发展的核心引擎,在推动产业转型升级、提升国家竞争力方面发挥着关键作用。

报告期内,公司紧跟行业发展趋势,加大研发投入,持续推进技术创新,不断提升核心竞争力。在算力基础设施领域,公司凭借深厚的技术积累和丰富的行业经验,成功中标多个重大项目和标杆案例,业务规模持续扩大,市场地位稳步提升。

2025年,全球及国内集成电路行业保持高速增长,在人工智能、算力基础设施、汽车智能化等下游需求驱动下,行业整体景气度持续提升。作为信息技术产业的核心,集成电路行业是支撑经济社会发展的基础性和先导性产业。2025年全球半导体市场规模持续扩大,逻辑芯片、存储芯片、交换芯片等细分领域增速显著高于行业平均水平。

2025年5月,国家工业和信息化部印发《算力基础设施行动计划(2025-2030年)》,重点任务是统筹算力资源、提升算力供给能力、优化算力应用生态、推动算力基础设施高质量发展。算力基础设施作为数字经济发展的核心引擎,在推动产业转型升级、提升国家竞争力方面发挥着关键作用。

报告期内,公司紧跟行业发展趋势,加大研发投入,持续推进技术创新,不断提升核心竞争力。在算力基础设施领域,公司凭借深厚的技术积累和丰富的行业经验,成功中标多个重大项目和标杆案例,业务规模持续扩大,市场地位稳步提升。

2025年,全球及国内集成电路行业保持高速增长,在人工智能、算力基础设施、汽车智能化等下游需求驱动下,行业整体景气度持续提升。作为信息技术产业的核心,集成电路行业是支撑经济社会发展的基础性和先导性产业。2025年全球半导体市场规模持续扩大,逻辑芯片、存储芯片、交换芯片等细分领域增速显著高于行业平均水平。

符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议程序
本次会议经全体董事一致同意,审议通过以下议案:
(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2025年度财务报告及其摘要》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2025年度财务报告》及摘要。

(四)审议通过《2025年度利润分配预案》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《2025年度利润分配预案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-65,481.55万元,母公司2025年度实现净利润-12,839.76万元,不提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币96,056.42万元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负的情况,综合考虑市场环境、行业现状和公司未来发展规划,为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施,稳步推进公司高质量发展,更好地保护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-021)。

(八)审议通过《董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》。

(九)审议通过《会计师事务所对会计师事务所2025年度履职情况评价报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《会计师事务所对会计师事务所2025年度履职情况评价报告》。

(十)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十一)审议通过《关于确认公司2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员回避表决,并同意将该议案直接提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(公告编号:2026-022)。

(十三)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(公告编号:2026-023)。

(十四)审议通过《关于变更注册名称的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册名称的公告》(公告编号:2026-024)。

(十五)审议通过《关于修订制定公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于修订制定公司部分治理制度的议案》(公告编号:2026-025)。

(十六)审议通过《2026年第一季度报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

北京万通新发展集团股份有限公司2026年第一季度经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》,第一号——房地产业的要求,北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度房地产业务主要经营数据如下:

一、公司2026年第一季度经营情况
2026年1-3月,公司房地产业务实现合同销售总面积0.113万平方米,与上年同期同比减少41%;实现合同销售金额2,137.31万元,与上年同期减少48%。

二、公司2026年一季度出租情况
2026年1-3月,公司房地产业务实现合同出租总面积13.28万平方米,与上年同期相比基本持平;实现合同租金收入总金额3,651万元,与上年同期减少21%。

三、公司2026年一季度新增土地储备及竣工情况
2026年1-3月,公司无新增土地储备,无新开工及在建、竣工面积。

以上经营数据未经审计,仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。
特此公告
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

附件:公司2026年第一季度房地产业务主要经营数据
1. 报告期内房地产业务销售情况

Table with 10 columns: Item (项目), 新增销售面积(万平方米) (新增销售面积(万平方米)), 新增销售金额(万元) (新增销售金额(万元)), 新增销售套数(套) (新增销售套数(套)), 新增销售均价(元/平方米) (新增销售均价(元/平方米)), 新增销售面积占比(%) (新增销售面积占比(%)), 新增销售金额占比(%) (新增销售金额占比(%)), 新增销售套数占比(%) (新增销售套数占比(%)), 新增销售均价占比(%) (新增销售均价占比(%)), 同比增减(%) (同比增减(%)).

注:其他主要是北京、天津、成都尾盘项目销售产生的签约。
2. 报告期内房地产业务出租情况

Table with 10 columns: Item (序号), 项目名称 (项目名称), 出租物业类型 (出租物业类型), 出租面积(万平方米) (出租面积(万平方米)), 出租金额(万元) (出租金额(万元)), 出租套数(套) (出租套数(套)), 出租均价(元/平方米) (出租均价(元/平方米)), 出租面积占比(%) (出租面积占比(%)), 出租金额占比(%) (出租金额占比(%)), 出租套数占比(%) (出租套数占比(%)), 同比增减(%) (同比增减(%)).

公司代码:600246 公司名称:万通发展
北京万通新发展集团股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 未审计财务报表

未审计财务报表
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
四、所有者权益变动表

五、分部报告
六、关联方关系及其交易
七、承诺及或有事项
八、资产负债表日后事项
九、其他重要事项

十、补充资料
十一、备查文件目录
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项

十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项

二十、其他重要事项
二十一、其他重要事项
二十二、其他重要事项
二十三、其他重要事项
二十四、其他重要事项

二十五、其他重要事项
二十六、其他重要事项
二十七、其他重要事项
二十八、其他重要事项
二十九、其他重要事项

三十、其他重要事项
三十一、其他重要事项
三十二、其他重要事项
三十三、其他重要事项
三十四、其他重要事项

三十五、其他重要事项
三十六、其他重要事项
三十七、其他重要事项
三十八、其他重要事项
三十九、其他重要事项

四十、其他重要事项
四十一、其他重要事项
四十二、其他重要事项
四十三、其他重要事项
四十四、其他重要事项

四十五、其他重要事项
四十六、其他重要事项
四十七、其他重要事项
四十八、其他重要事项
四十九、其他重要事项

五十、其他重要事项
五十一、其他重要事项
五十二、其他重要事项
五十三、其他重要事项
五十四、其他重要事项

五十五、其他重要事项
五十六、其他重要事项
五十七、其他重要事项
五十八、其他重要事项
五十九、其他重要事项

六十、其他重要事项
六十一、其他重要事项
六十二、其他重要事项
六十三、其他重要事项
六十四、其他重要事项

六十五、其他重要事项
六十六、其他重要事项
六十七、其他重要事项
六十八、其他重要事项
六十九、其他重要事项

七十、其他重要事项
七十一、其他重要事项
七十二、其他重要事项
七十三、其他重要事项
七十四、其他重要事项

七十五、其他重要事项
七十六、其他重要事项
七十七、其他重要事项
七十八、其他重要事项
七十九、其他重要事项

半、低功耗、低功耗等核心优势。2025年,PCIe高速交换芯片作为实现设备拓展与芯片间高速数据传输的核心硬件,通过高带宽、低延迟互连通道提升系统性能。在AI计算、服务器、高端存储及高端车载平台等关键领域,PCIe高速交换芯片成为不可或缺的核心部件。随着AI算力需求爆发,PCIe交换芯片成为AI算力系统的必备核心部件,搭载自研(Fabric Link)功能的高端PCIe交换芯片,可实现CPU间高效通信与大规模组网,大幅提升服务器Scale-up节点。2025年市场中,高端PCIe 5.0 Switch芯片产量多数美元至1.8亿美元,部分高性能型号产能仍存供不应求现象,供不应求的现象,国产替代产品具备显著的性价比与交付优势。

(2) PCIe技术发展现状
2025年,PCIe 5.0芯片出货量快速增长,传输速率达32GT/s,已全面覆盖服务器、存储系统、车载计算等场景。成为云计算、人工智能、高性能计算领域的核心互连标准之一。PCIe 6.0产品在2025年,在2025年商用前,国际大厂均已推出相关产品,预计2026年开始部署,2027年实现大规模部署;PCIe 7.0标准于2024年公布,2025年完成规范落地,单向速率可达128GT/s,面向下一代超大规模算力集群拓展技术储备,与PCIe高阶应用的CXL(Compute Express Link)技术在2025年实现规模化商用。CXL通过统一内存实现CPU、GPU、存储设备的高效协同,与PCIe交换芯片形成互补,赋能生成式AI产业链协同,提升AI算力集群计算资源池化。

(3) Scale-up(集群)与超节点趋势
2025年,Scale-up(集群)与超节点互连协议在国内市场呈现高度分散、尚未收敛的竞争格局,形成了“私有协议主导高端,开放标准加速崛起”的二元生态,不同技术路线各有侧重,尚未形成统一行业规范。2025年虽有UAI/InfiniBand等开放标准加速推进,但不同方案在互连性能、路由算法、内存模型等核心层面仍存在显著差异,行业标准尚未收敛,客户面临“生态割裂”与“方案选择”的两难困境。数通科技紧跟PCIe、CXL等国际标准并实现应用,精准把握Scale-up产业链发展趋势,进行前瞻性研发和产品布局。

2. 所处行业市场概况
(1) 全球PCIe交换芯片行业规模
2025年,全球PCIe交换芯片市场受益于AI算力与数据中心需求爆发,市场规模实现稳步增长,整体规模突破千亿美元,同比增长14.8%。其中PCIe 5.0产品与市场规模占比超70%,PCIe 6.0产品开始放量,成为行业新增量。根据S&S INSIDER预测,2030年全球PCIe交换芯片市场规模将达到135.3亿美元,2023-2030年间复合增长率(CAGR)为14.5%。

(2) 国内PCIe交换芯片行业规模
2025年,国内PCIe交换芯片市场受益于AI算力与数据中心需求爆发,市场规模实现稳步增长,整体规模突破千亿美元,同比增长14.8%。其中PCIe 5.0产品与市场规模占比超70%,PCIe 6.0产品开始放量,成为行业新增量。根据S&S INSIDER预测,2030年全球PCIe交换芯片市场规模将达到135.3亿美元,2023-2030年间复合增长率(CAGR)为14.5%。

(3) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(4) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(5) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(6) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(7) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(8) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(9) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(10) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(11) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(12) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(13) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(14) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(15) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(16) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(17) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(18) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(19) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(20) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(21) ASIC定制趋势
数通科技自主研发、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。

(22) 异构计算解决方案
依托自主研研、完全自研的高速交换芯片核心技术,公司构建了从板级系统到芯片级定制的一体化定制能力。基于自研互连交换芯片开发的专用GPU互连组网,通过深度定制化设计与板级优化,实现芯片性能最大化释放,形成难以复制的板级系统技术优势,面向目标应用场景提供定制化、整体交付的解决方案。以自研芯片为底座核心,结合自主研发的软件栈,构建Scale-up超节点架构,实现CPU与GPU之间、CPU与设备之间、CPU与GPU之间、以及GPU和设备之间的高效互连。